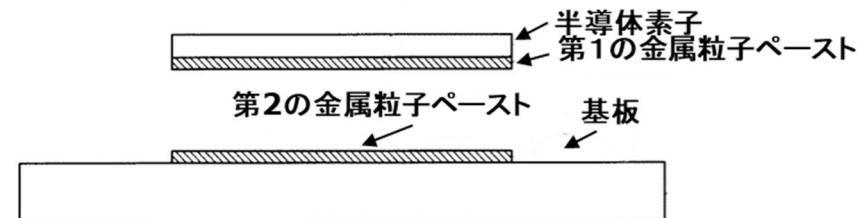


利用シーン(展開可能分野)

半導体素子と基板を加熱して接合するとき、2段階の焼成により、半導体素子および基板上に第1、第2の焼結パターンを形成し、その後、第3の焼結パターンを形成する。金属コアの熱膨張率と接合材料層の熱膨張率との差による接合材料層の剥離やクラックが発生を防止し、接合の信頼性を向上させる半導体装置の接合方法。



発明の効果 (新規性・優位性)

半導体素子と第1の接合材料層との接合性(導電性・熱伝導性)、および、基板と第2の接合材料層との接合性(導電性・熱伝導性)を向上。

想定するライセンシー像 (保有技術や事業領域)

パワー半導体のみならず、パワーモジュールの製造販売を検討している企業を想定。